

DE 100 47 963 A 1

24

23

andere Bauteilschicht im Schritt des Verbindens an einem anderen klebenden Substrat als dem Halbleitersubstrat befestigt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Halbleitersubstrat (11) aus Silicium (Si) 5 oder Germanium (Ge) hergestellt wird.

17. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteilschicht (20, 40) durch epitaktisches oder heteroepitaktisches Wachstum auf dem Halbleitersubstrat (11) hergestellt wird. 10

18. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt des Verbindens der Bauteileinheit zwei Bauteileinheiten (2, 4) unter Verwendung eines Klebers aneinander befestigt werden.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kleber aus isolierendem Material verwendet wird. 15

20. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass ein Trägersubstrat mit Durchgangslöchern verwendet wird, die ein Flussmittel zum Lösen 20 des Klebers hindurchtreten lassen.

21. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleber in einen vorgegebenen Raum auf der der Bauteilschicht zugewandten Seite des Trägersubstrats eingebracht wird. 25

22. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Bauteilschichten auf einem Trägersubstrat aufgebracht werden.

23. Verfahren zum Herstellen eines Dünffilm-Bauteils mit mehreren Bauteilschichten, mit den folgenden 30 Schritten:

- Herstellen einer internen Isolierschicht (130) aus einem isolierenden Material in einer Halbleiterschicht (13) mit einem Paar Oberflächen;
- Herstellen einer ersten Bauteilschicht (20) auf 35 einer Seite der Halbleiterschicht und
- Herstellen einer zweiten Bauteilschicht (40) auf der anderen Seite der Halbleiterschicht

24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt des Herstellens der internen 40 Isolierschicht (130) Ionen in die Halbleiterschicht (13) implantiert werden.

25. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Halbleiterschicht (13) auf einem eine 45 poröse Schicht einbettenden Halbleitersubstrat hergestellt wird.

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass die poröse Schicht durch Anodisieren auf dem Halbleitersubstrat hergestellt wird.

27. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Halbleiterschicht durch epitaktisches 50 Wachstum auf dem Halbleitersubstrat hergestellt wird.

28. Dünffilm-Bauteil mit mehreren Bauteilschichten (20, 40), das eine Licht emittierende Bauteilschicht (80) und eine Licht empfangende Fotodetektorschicht (50) 55 aufweist.

29. Dünffilm-Bauteil nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht emittierende Bauteilschicht (50) unter Verwendung eines Klebers an der Fotodetektorschicht (80) befestigt wird. 60

30. Dünffilm-Bauteil nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht emittierende Bauteilschicht (50) so hergestellt wird, dass sie Licht im Winkel 65 rechtwinklig zu einer Oberfläche emittiert.

Hierzu 24 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

ZEICHNUNGEN SEITE 1

Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:

DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

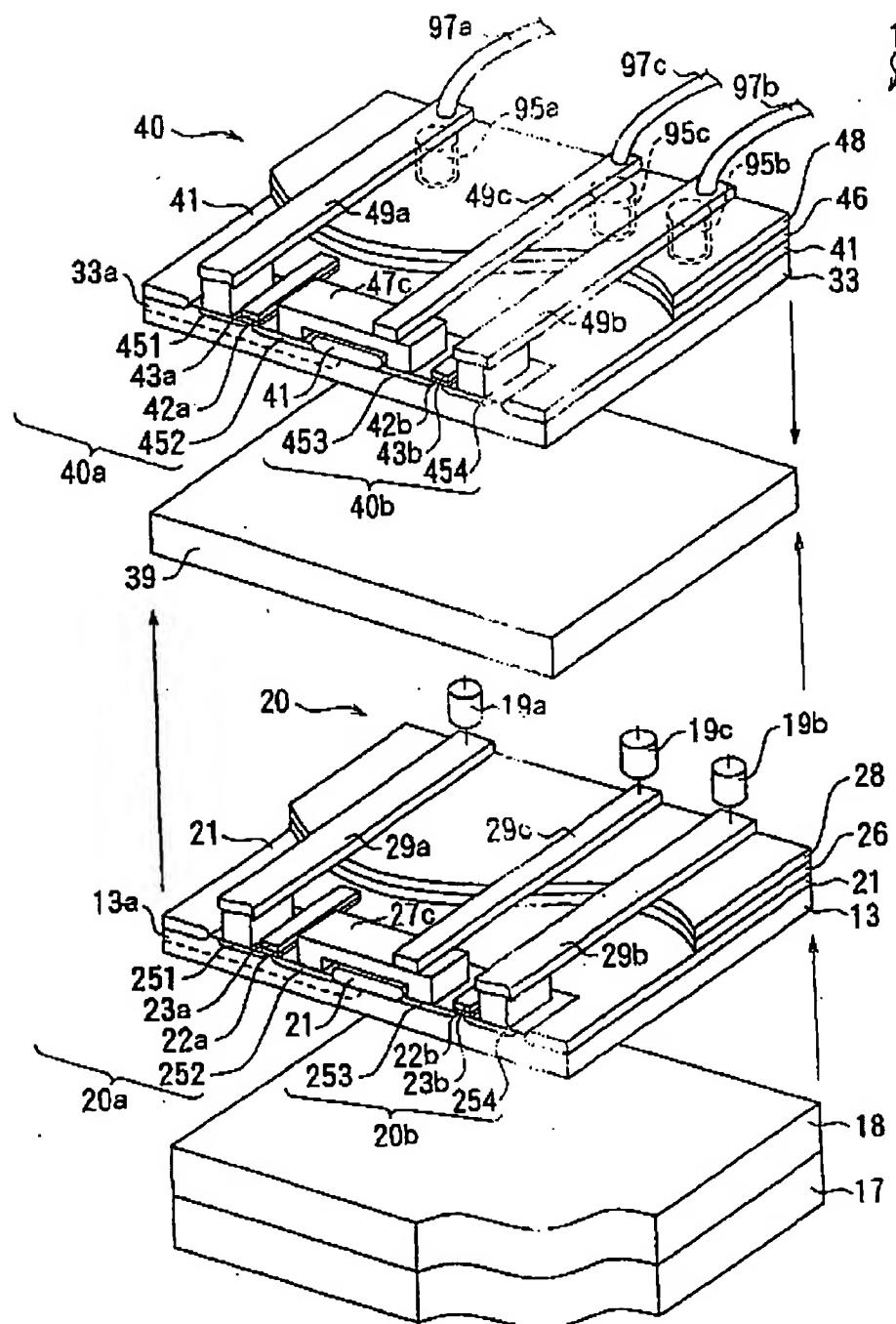


FIG.1

ZEICHNUNGEN SEITE 2

Nummer: DE 100 47 963 A1
 Int. Cl.?: H 01 L 25/04
 Offenlegungstag: 29. März 2001

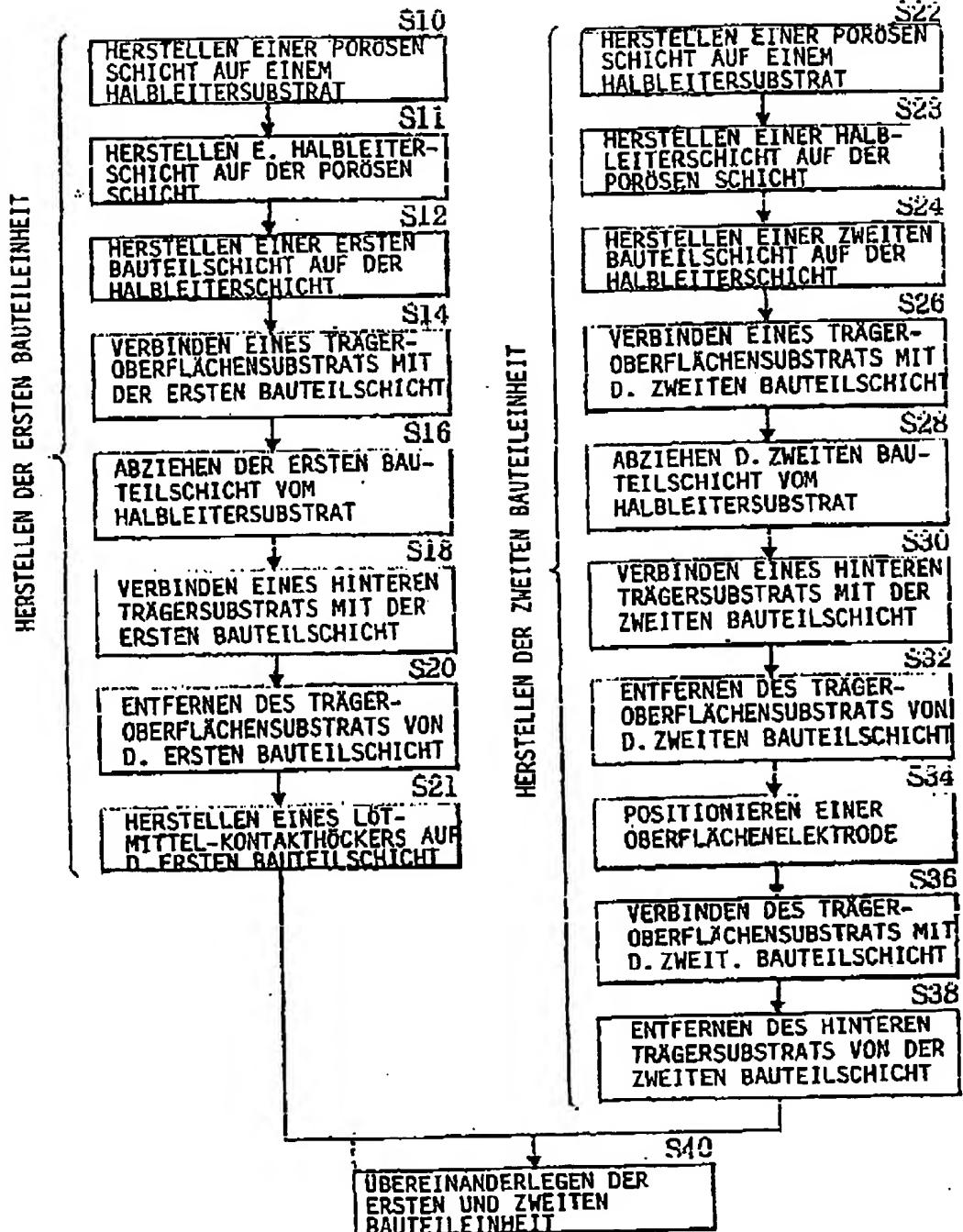


FIG.2

ZEICHNUNGEN SEITE 3

Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:

DE 100 47 963 A1
H01 L 25/04
29. März 2001

FIG.3A



FIG.3B



FIG.3C

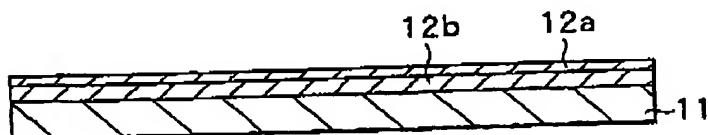
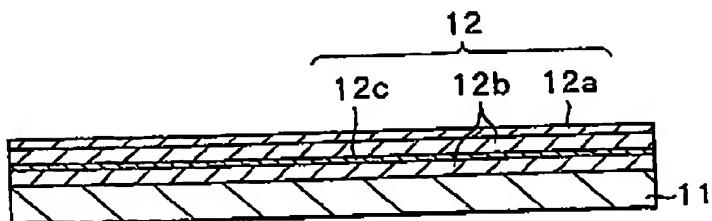


FIG.3D



ZEICHNUNGEN SEITE 4

Nummer:
Int. Cl.⁷:
Offenlegungstag:

DE 100 47 063 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.4A

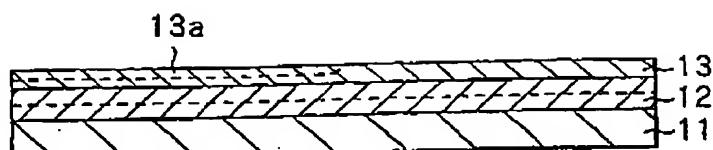


FIG.4B

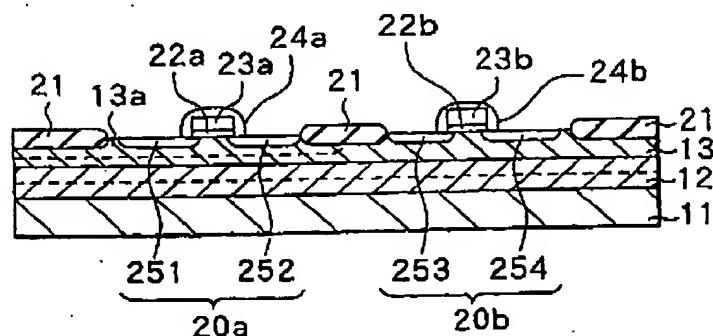


FIG.4C

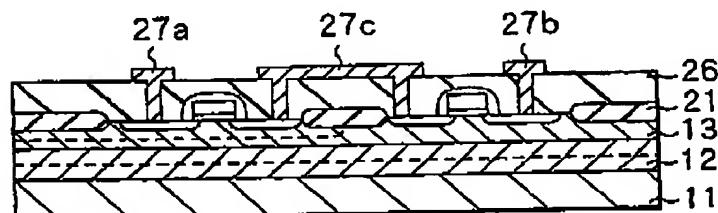
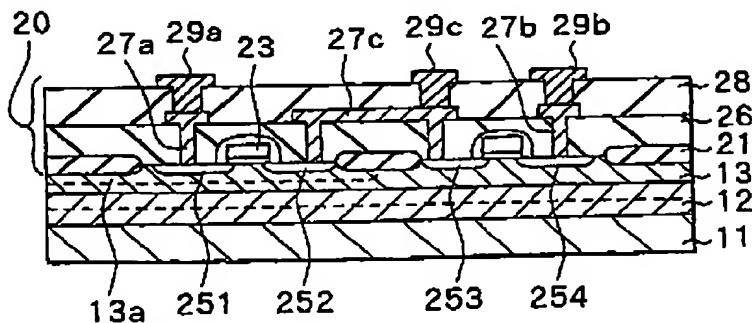


FIG.4D



ZEICHNUNGEN SEITE 5

Nummer:
Int. Cl.?
Offenlegungstag:

DE 100 47 863 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.5A

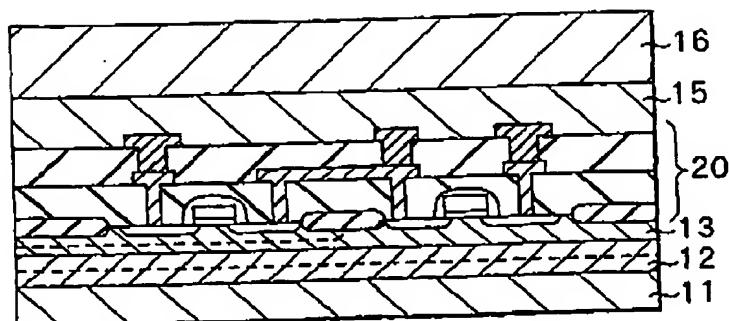


FIG.5B

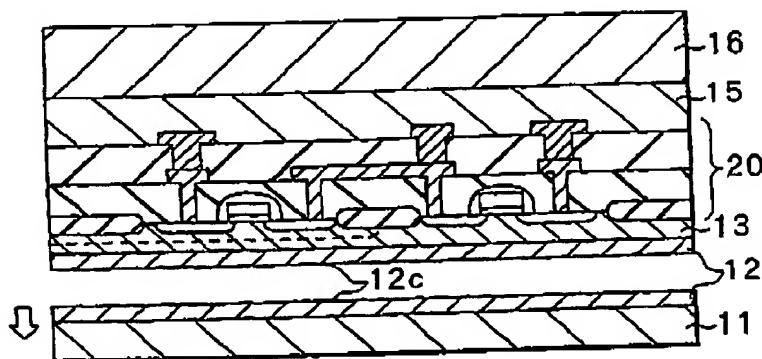
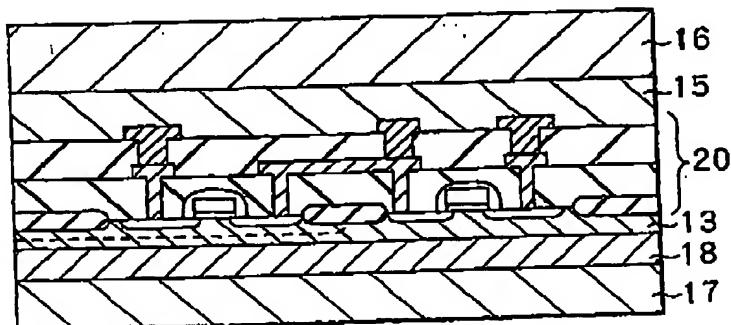


FIG.5C



ZEICHNUNGEN SEITE 6

Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:

DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.6A

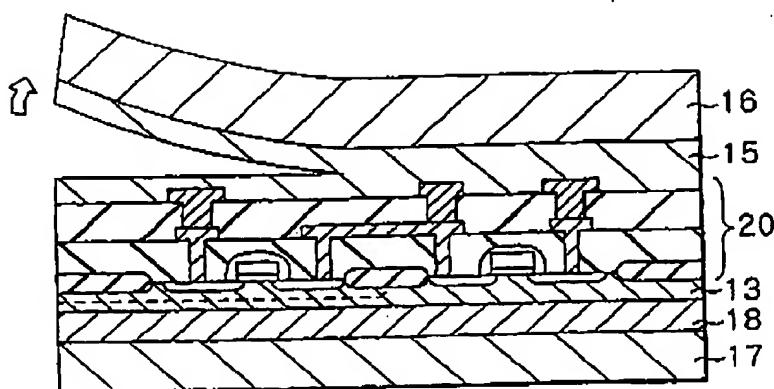
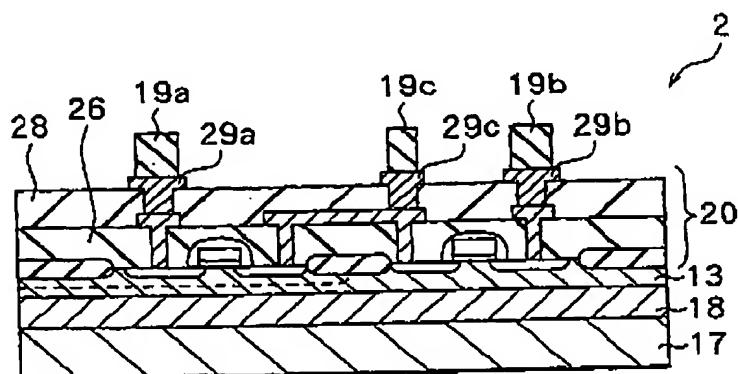


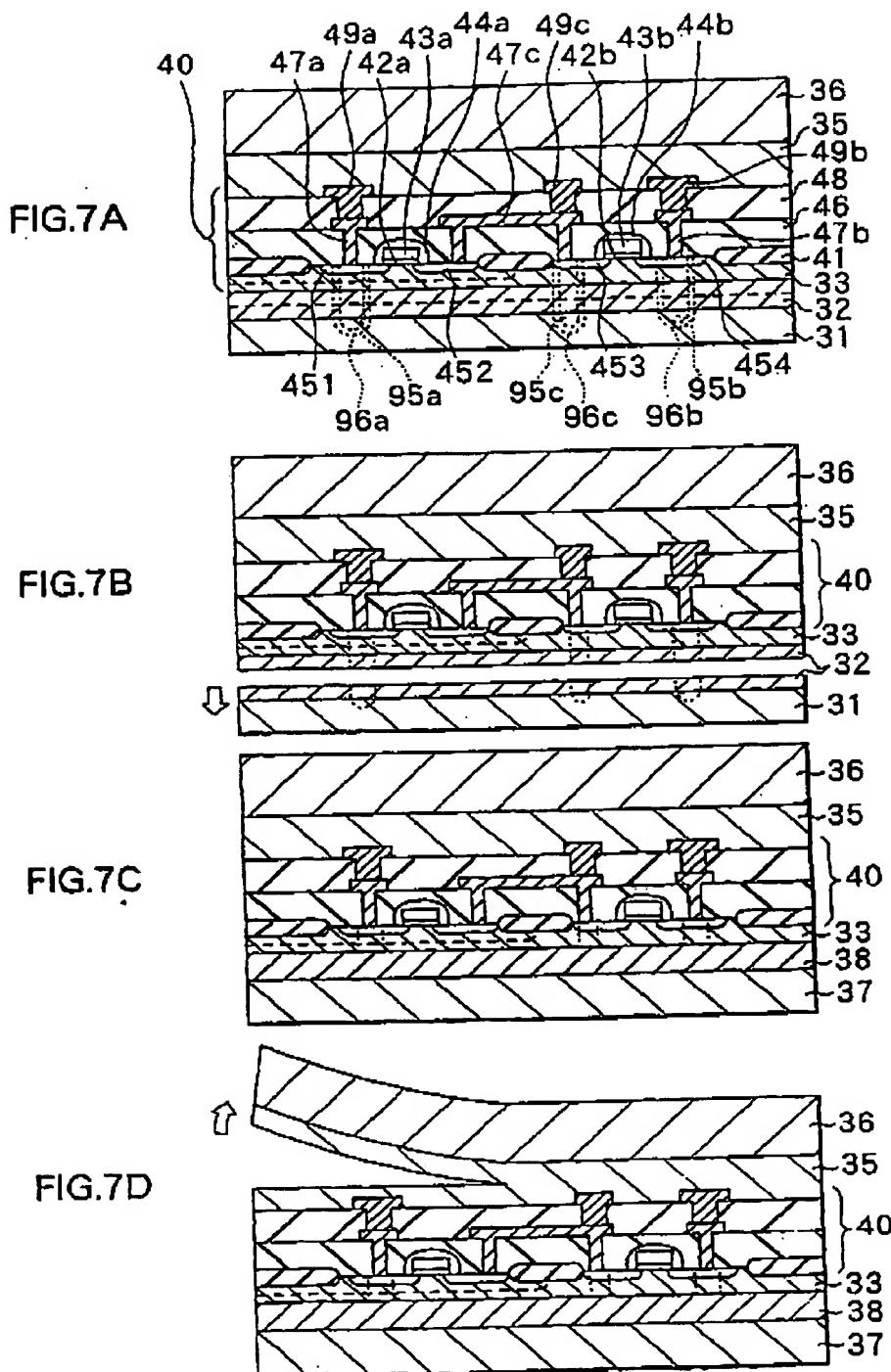
FIG.6B



ZEICHNUNGEN SEITE 7

Nummer:
Int. Cl. 7:
Offenlegungstag:

DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001



ZEICHNUNGEN SEITE 8

Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.8A

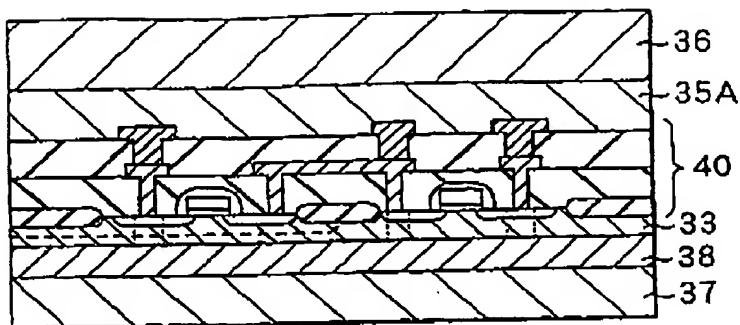


FIG.8B

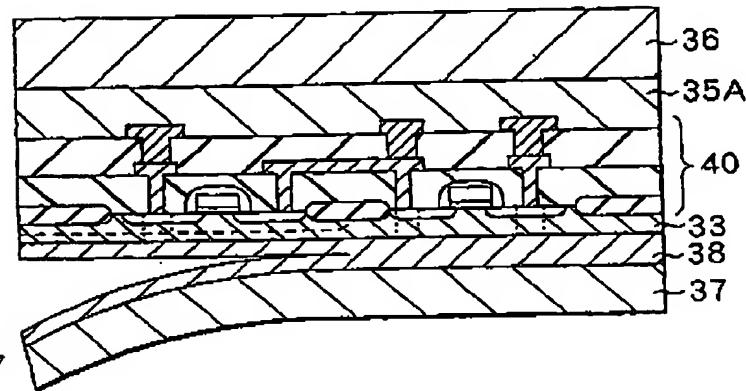
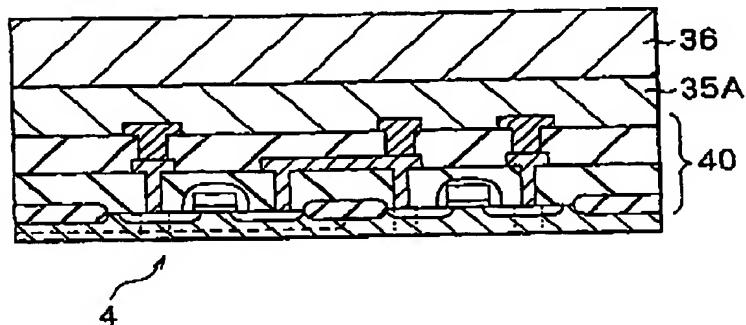


FIG.8C



102 013/142

ZEICHNUNGEN SEITE 9

DE 100 47 983 A1
HO1 L 25/04
Offenlegungstag:

DE 100 47 983 A1
HO1 L 25/04
29. März 2001

FIG.9A

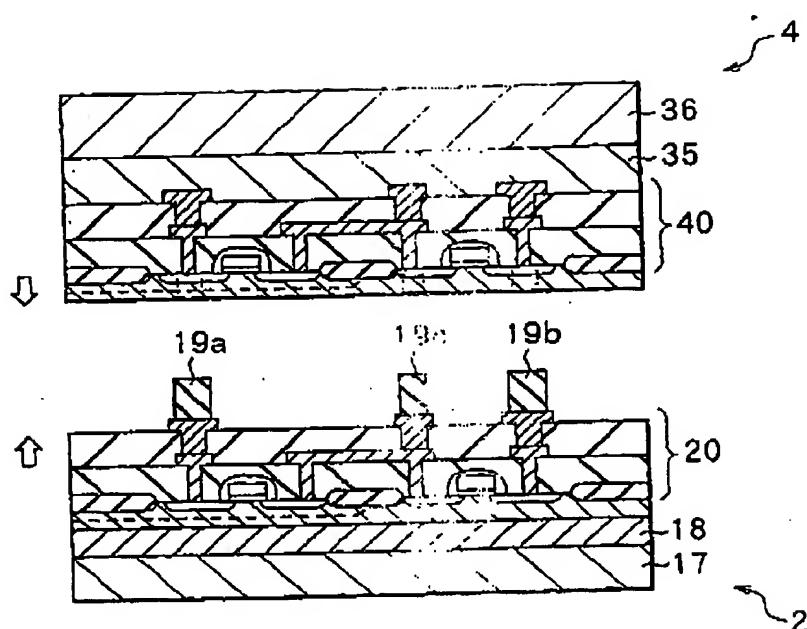
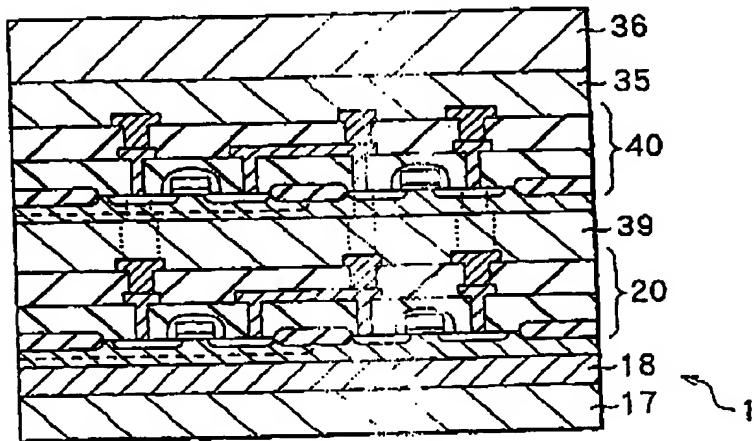


FIG.9B



ZEICHNUNGEN SEITE 10

Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:

DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.10A

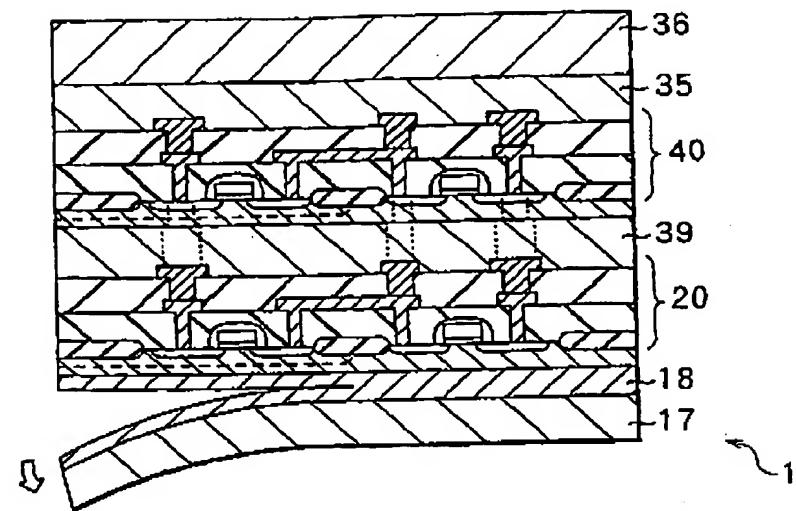
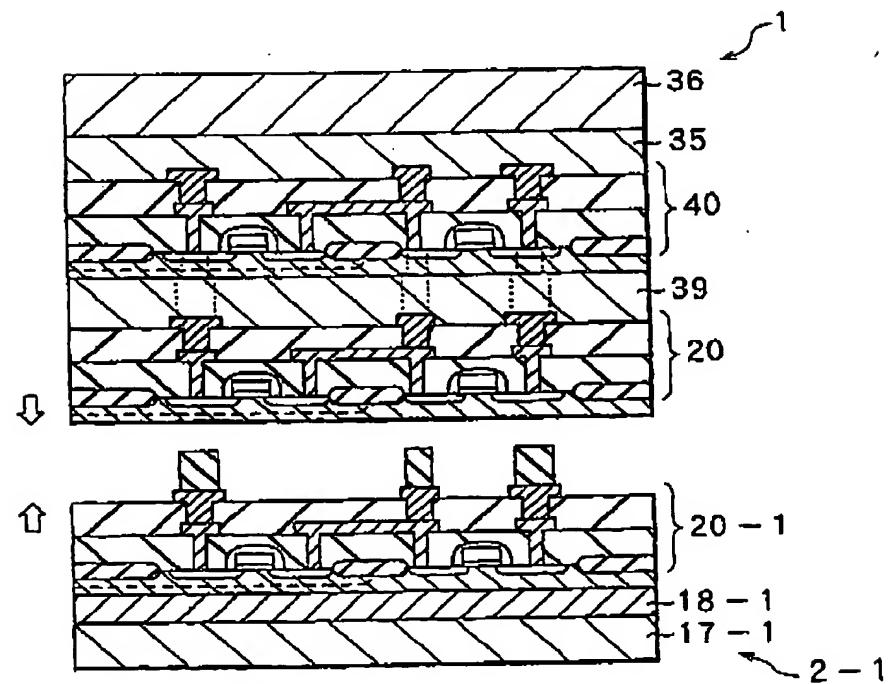


FIG.10B



ZEICHNUNGEN SEITE 11

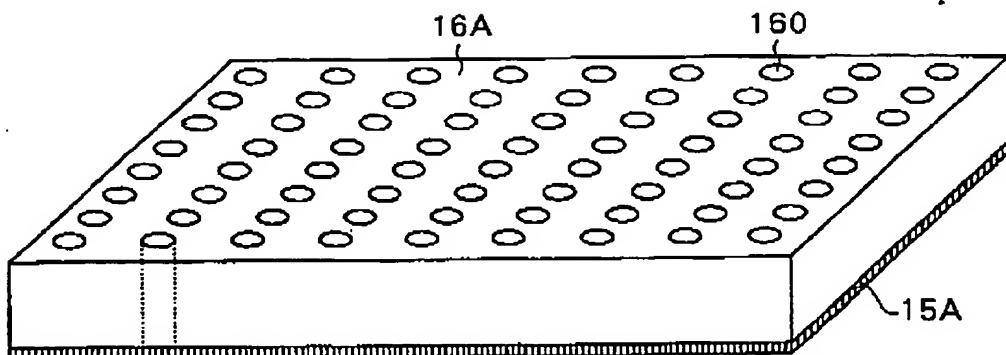
Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.11

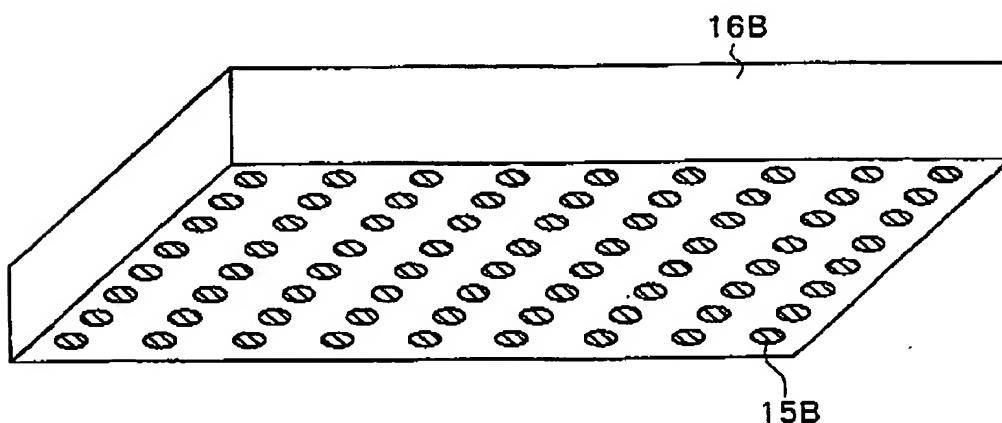


FIG.12

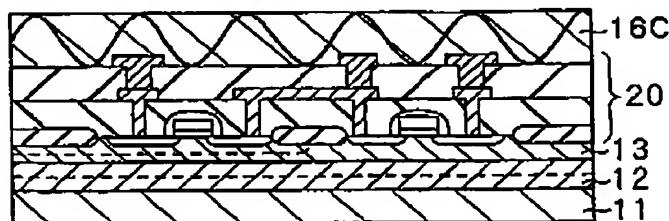


FIG.13

ZEICHNUNGEN SEITE 12

Nummer: DE 100 47 963 A1
 Int. Cl.: H 01 L 25/04
 Offenlegungstag: 29. März 2001

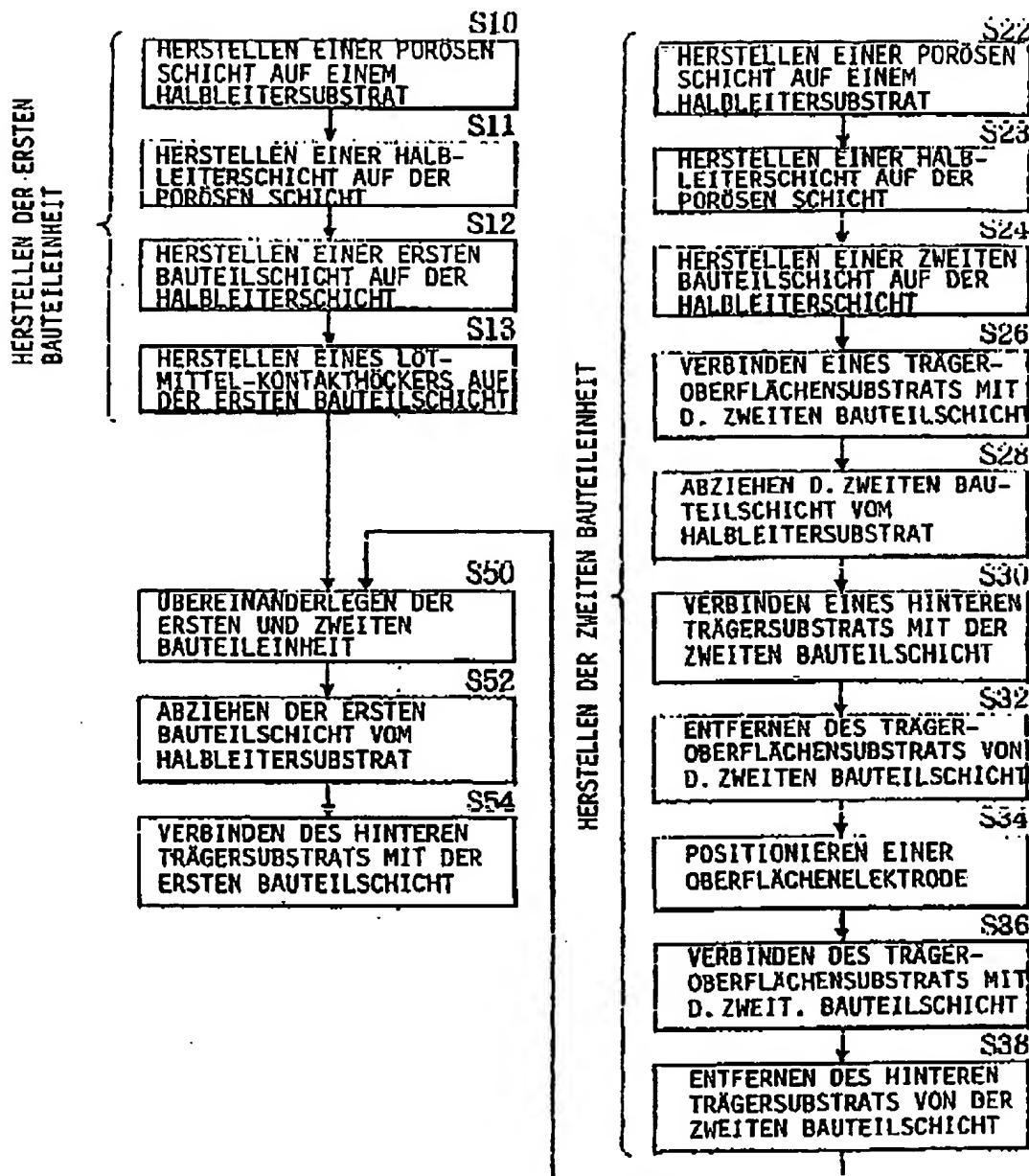
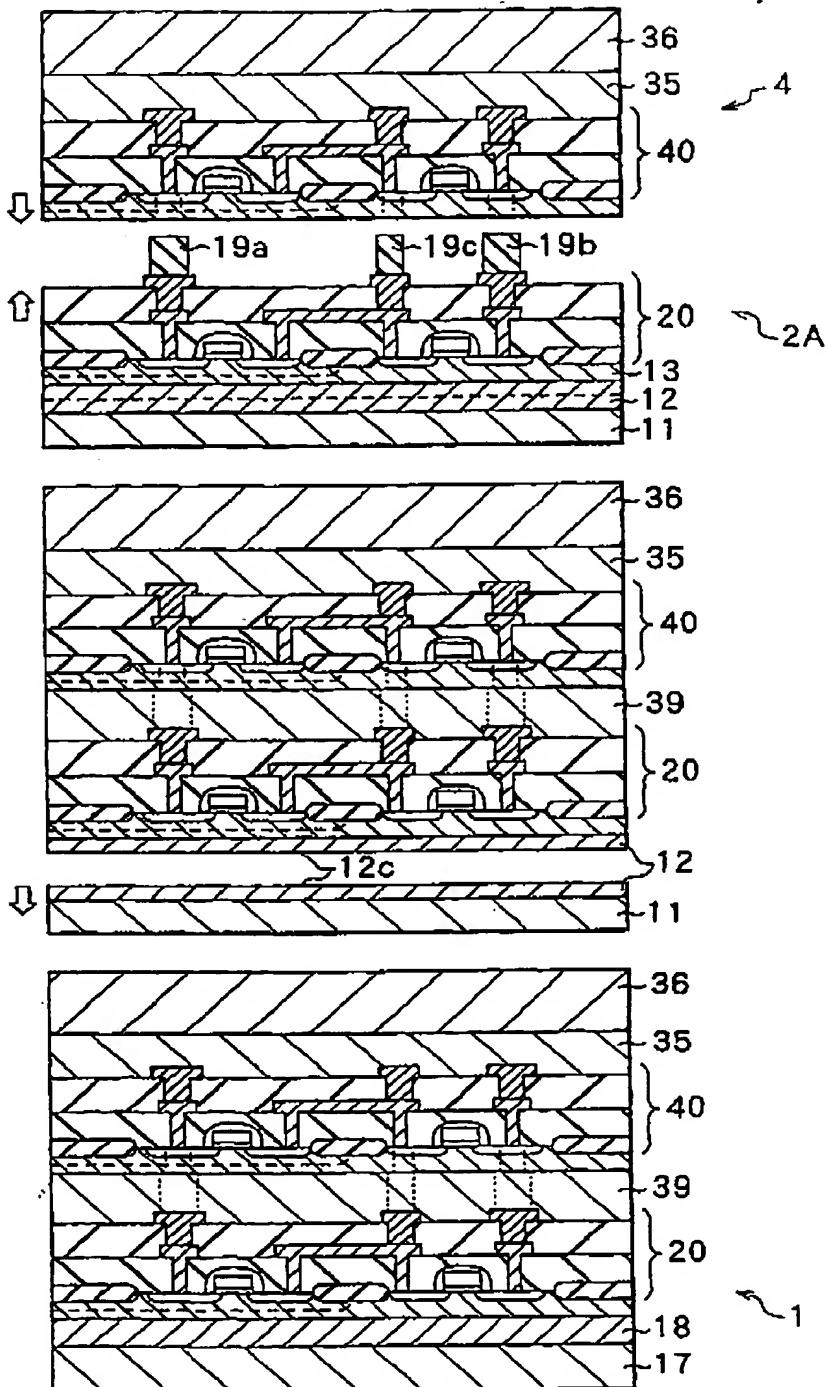


FIG.14

ZEICHNUNGEN SEITE 13

Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:

DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001



ZEICHNUNGEN SEITE 14

Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:

DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

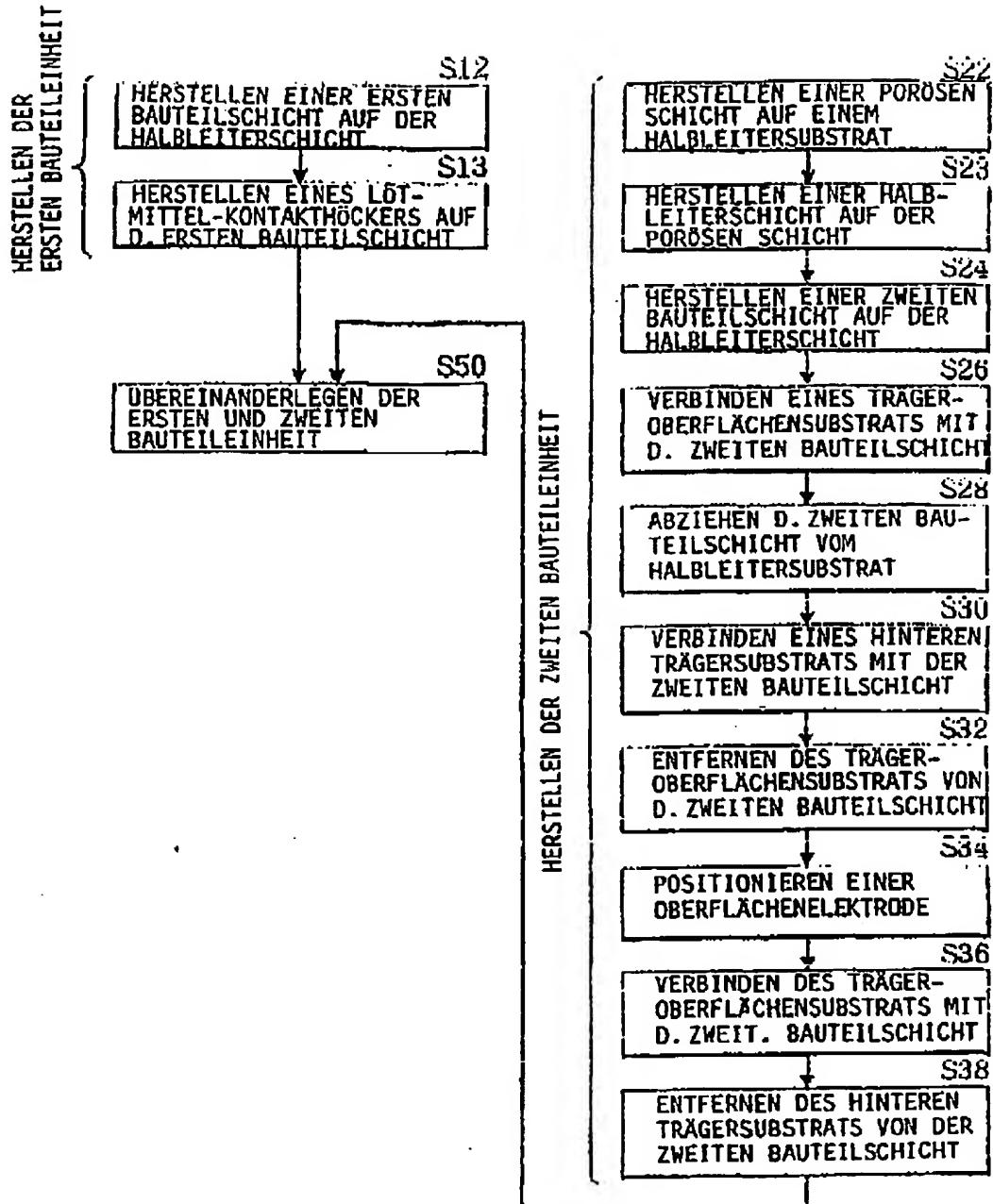


FIG.16

ZEICHNUNGEN SEITE 16

Nummer:
Int. Cl.⁷:
Offenlegungstag:DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.17A

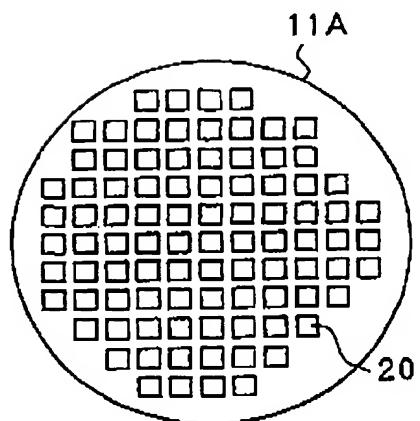
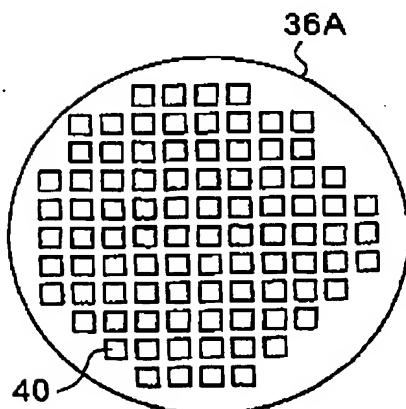


FIG.17B



ZEICHNUNGEN SEITE 16

Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:DE 100 47 983 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.18A

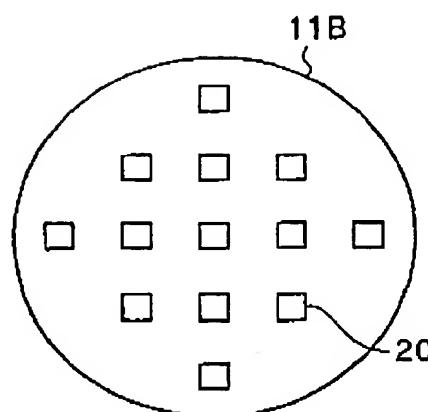


FIG.18B

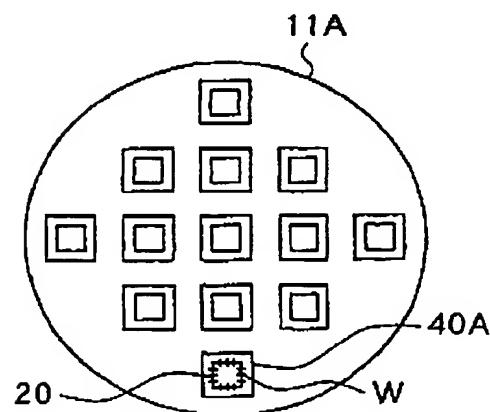
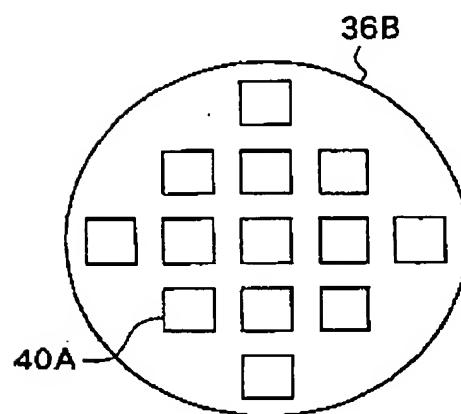


FIG.19

ZEICHNUNGEN SEITE 17

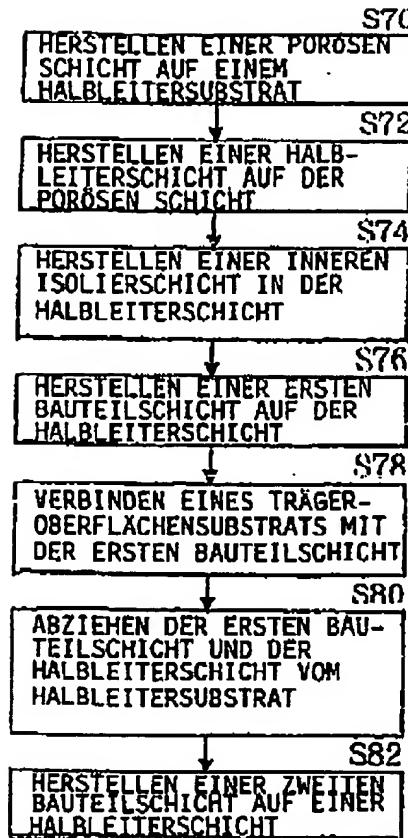
Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.20

ZEICHNUNGEN SEITE 18

Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:

DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.21A

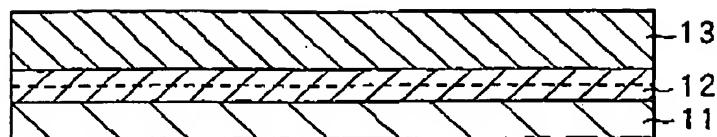


FIG.21B

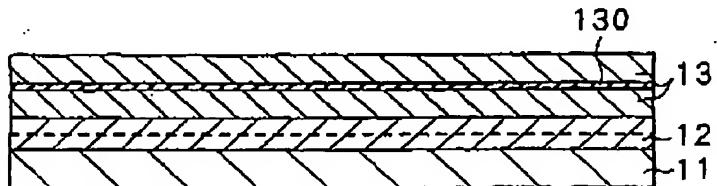


FIG.21C

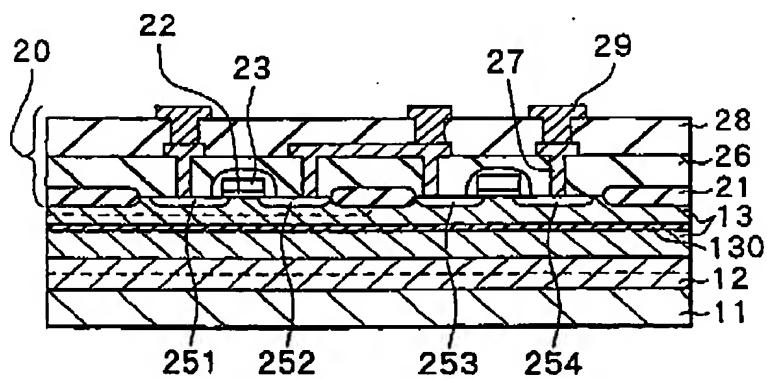
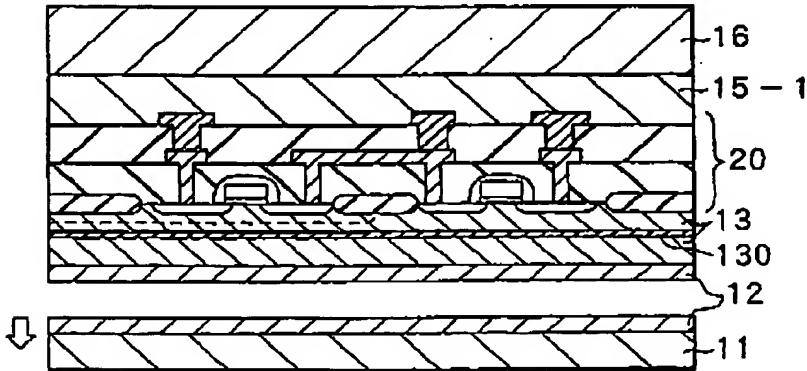


FIG.21D



ZEICHNUNGEN SEITE 19

Nummer:
Int. Cl.':
Offenlegungstag:

DE 100 47 983 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.22A

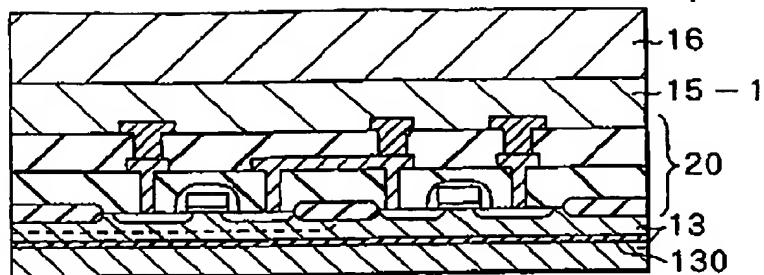
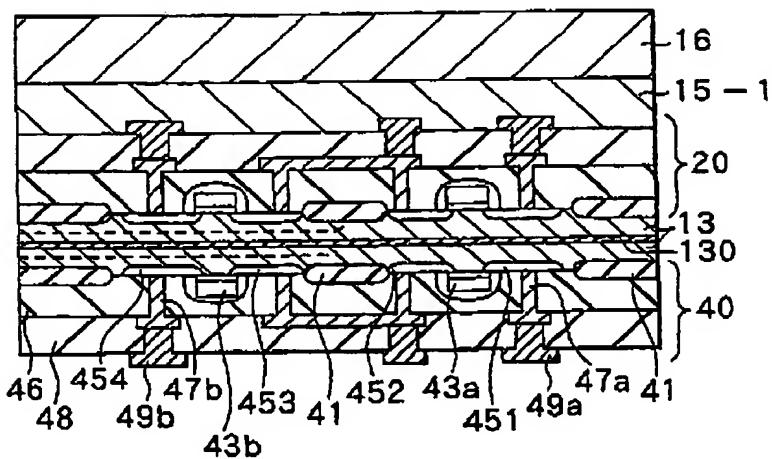


FIG.22B



ZEICHNUNGEN SEITE 20

Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:

DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.23A

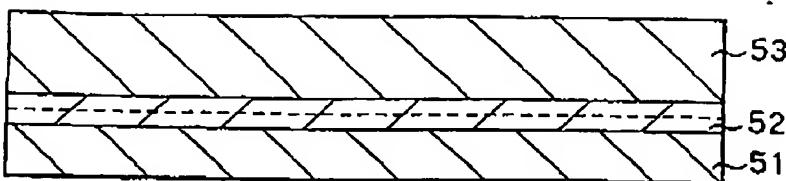


FIG.23B

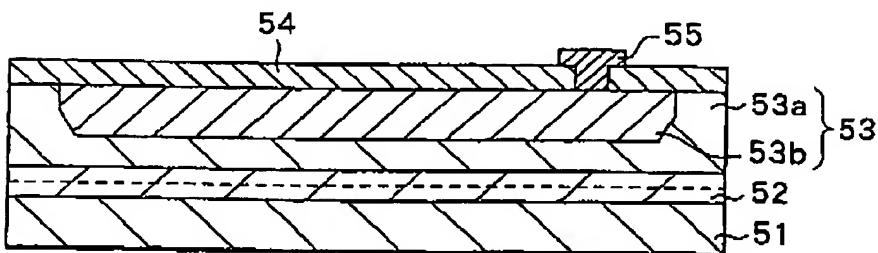


FIG.23C

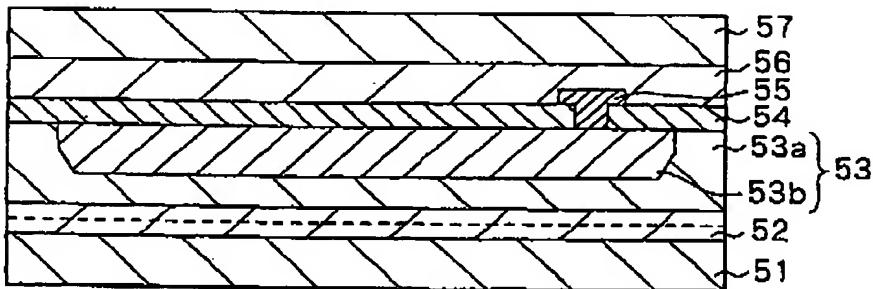
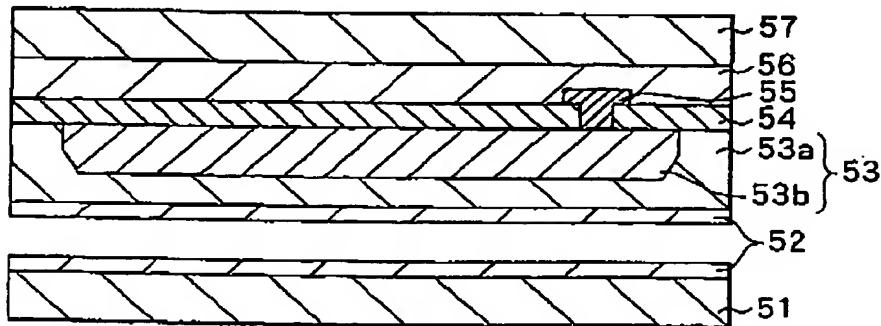


FIG.23D



ZEICHNUNGEN SEITE 21

Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.24A

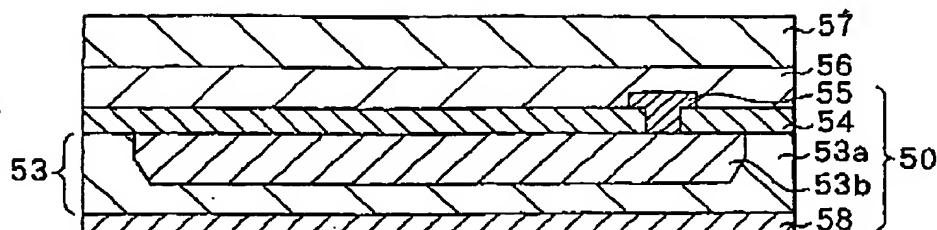


FIG.24B

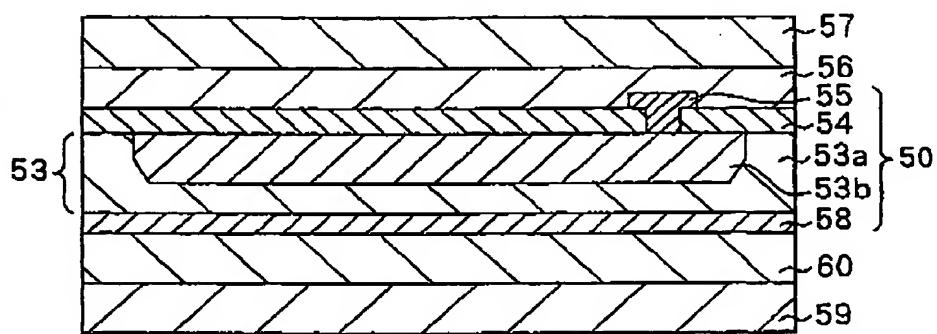
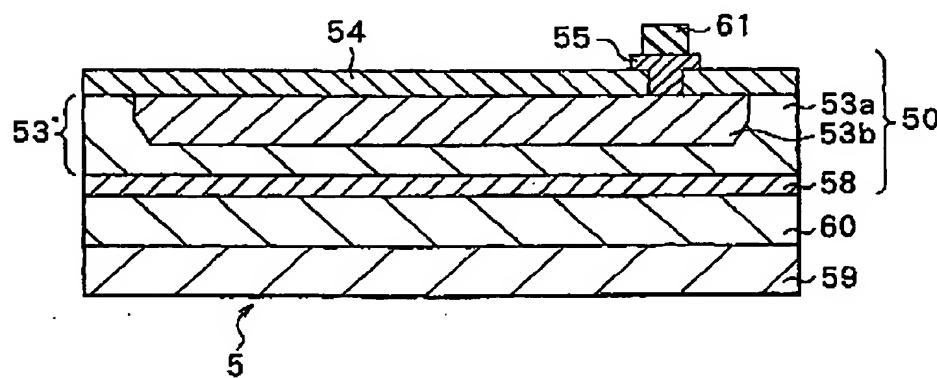


FIG.24C



ZEICHNUNGEN SEITE 22

Nummer:
Int. Cl.⁷:
Offenlegungstag:DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.25A

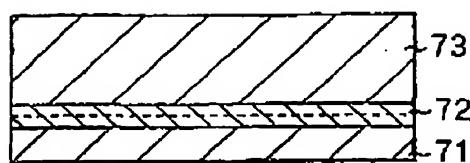


FIG.25B

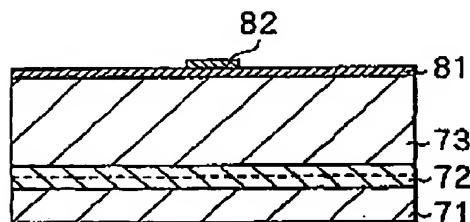


FIG.25C

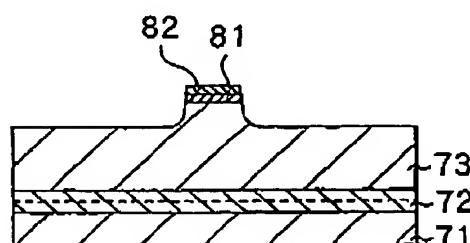


FIG.25D

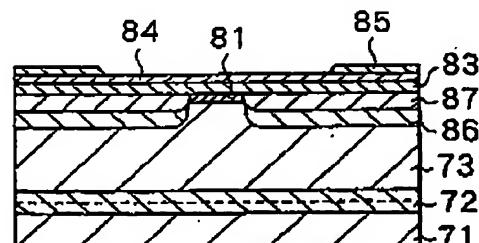
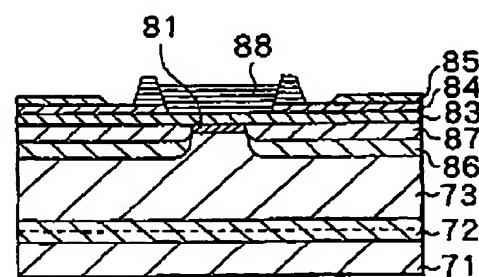


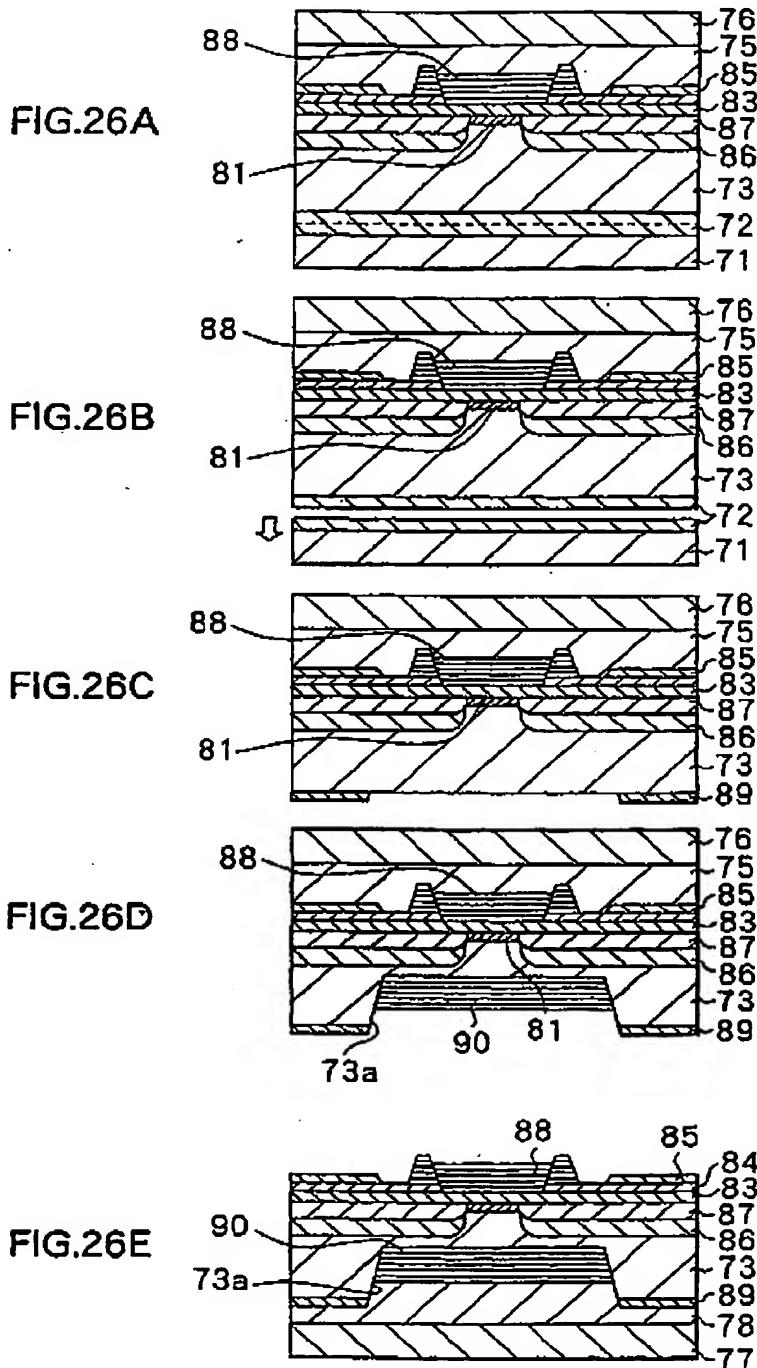
FIG.25E



ZEICHNUNGEN SEITE 23

Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:

DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001



ZEICHNUNGEN SEITE 24

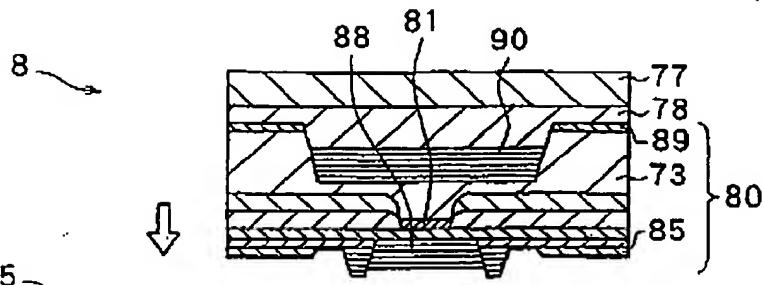
Nummer:
Int. Cl.?:
Offenlegungstag:DE 100 47 963 A1
H 01 L 25/04
29. März 2001

FIG.27A

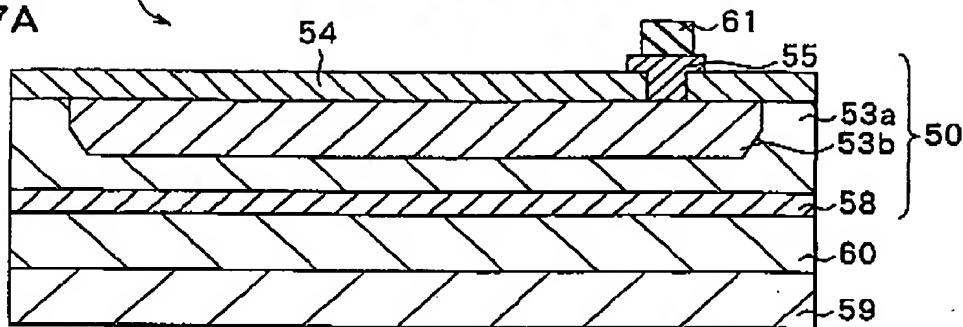


FIG.27B

